

초음파를 이용한 포장 밀봉

지속 가능한 미래 기술

플라스틱 용착

금속 용착

절단

세척

스크리닝

» Sustainability
» Zero Waste
→ Ultrasonics by Telsonic



SONIQTWIST®
Torsional welding | unique by Telsonic

Bronschhofen (스위스), 2020/08

소비 사회의 의식이 변하고 있으며 지속 가능하고 스마트한 포장 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 진정한 재활용 경제의 목표는 더 이상 플라스틱 복합재 재질의 포장재를 생산하지 않고 더 많은 단일 재료를 사용하는 경우에만 달성할 수 있습니다. 이를 통해 재활용률을 현저하게 높일 수 있습니다.

바이오플라스틱을 포함한 단일 재료 사용에 관한 이런 트렌드를 지원하기 위해 Telsonic에서는 글로벌 식품 생산업체에 빠르고 효율적이며 친환경적인 밀봉 기술을 제공하고 있습니다. 토셔널 초음파 실링 기술 SONIQTWIST®는 재료와 포장물 모두를 완벽하게 보호합니다. 이 기술은 특히 제품을 보호하고 공정 단계에서 안전하게 밀봉해야 하는 식품산업에서 큰 의미를 갖습니다. 목표는 "Zero Food Waste"(음식물 쓰레기 제로).

이 혁신적 초음파 기술은 포장이 100% 밀봉되는 조건에서 적은 에너지 투입 및 높은 클럭 속도를 지향합니다. 통계학적 분석 및 추적성의 보장을 위해 전체 실링 과정은 모니터링됩니다. 모든 데이터는 상응하는 인터페이스를 통해 호출하고 평가할 수 있습니다.

지속가능성은 우리 모두에게 중요한 주제입니다. Telsonic은 초음파 실링 기술의 기술 선도 기업으로서 어떤 과제에서도 여러분들을 지원할 것입니다.

당사의 오랜시간 동안 축적한 폭넓은 어플리케이션 지식에서 이익을 누리십시오. 문의사항이 있으시다면 지금 바로 Telsonic 패키징 팀에 연락하시기 바랍니다.



01 Carolin Reinbold, Key Account Manager, TELSONIC AG, Switzerland